

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026年6月)

证券代码：芯朋微

证券简称：688508

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国寿养老 国海证券 华泰电子 易方达
时间	2026年6月11日 2026年6月25日
地点	现场调研
上市公司接待人员姓名	投资总监 刘权
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，专注于为客户提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司主要产品为高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品，主要品类包括 AC-DC 电源产品线、DC-DC 电源产品线、Digital PMIC 电源产品线、驱动产品线、功率器件产品线和功率模块产品线等六大类，目前有效的产品型号超 2,000 款，全面覆盖服务器电源、通信、光伏/储能/充电桩、智能电网、工业电机、智能家电、智能终端的充电器适配器等众多领域。</p> <p>公司 2025 年实现营业收入 11.43 亿元，同比增长 18.47%；归母净利润 1.86 亿元，同比增长 67.34%；扣非</p>

净利润 5587 万元，同比下降 23.59%。其中新兴市场（服务器、通信、工控、光储充、新能源车）营收同比大幅增长 50%；新品类（DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）营收同比增长 39%，业务结构向高附加值领域优化。2026 年第一季度实现营业收入 2.94 亿元，同比下降 2.57%；归母净利润 1372 万元，同比下降 66.59%；扣非净利润 1903 万元，同比下降 45.01%。

二、主要问题及回复

1、公司新产品的进展情况？

公司持续升级的现有高低压集成核心技术平台，同时加大投入拓展了面向精密马达的低压电机驱动算法、数字电源多拓扑算法、新一代 FZVS 高效率电源架构技术、宽禁带器件智能化技术、大电流低压器件集成工艺技术等新功率技术平台，从而公司产品线不断丰富，收入规模稳步上升。针对家电市场，公司在 AC-DC 产品已覆盖的整机上搭配扩充电机 Driver 和电源 Driver（HV&LV）的驱动产品系列、功率器件及模块系列；针对适配器市场，公司自主研发的高集成快充初级控制功率芯片、次级同步整流芯片及 PD 协议芯片的全套片方案逐渐上量，下游应用场景从 10W 到 140W、从智能超结器件到氮化镓，碳化硅器件全覆盖；针对工业级电源市场，面向 800V HVDC 系统的 1700V SiC 辅源、高压隔离驱动、霍尔抗强磁电源芯片、无电解电容 AC-DC 芯片、SiC/GaN 驱动等芯片、兆赫兹开环 DCX 控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16 多相 VRM、70/90ACu-Clip DrMOS、EFuse、PoL 等高性能功率产品全面进入量产，逐步收获市场认可。截至 2025 年，公司在国内首家形成面向服务器等工业电源市场一次、二次、三次电源的整套系统功率解决方案。公司始终有序的依托核心技术平台，不断拓展新的产品线，

拓宽业务增长路径，扩大下游行业应用范围，实现阶梯式稳步增长。

2、公司目前研发投入情况？

2025 年公司研发费用投入 25,827.75 万元，2026 年一季度公司研发投入 5,897.67 万元，占营业收入的比例分别为 22.60% 和 20.08%。高比例的研发投入来源于持续不断的人才引进，以及长短期兼顾的薪酬包保障。截至 2025 年末，公司研发人员达到 299 人，占公司员工比例 69.86%。2025 年 4 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属工作，公司核心技术骨干及管理人员共 24 人完成登记 161.40 万股；2025 年 4 月，公司向 15 名核心骨干及管理人员授予预留 135 万股限制性股票。除股权激励计划之外，A 级员工、技术大拿等亦享受特别礼遇；多项人才举措意在给“火车头”加满油，勇往直前。公司注重功率集成电路的工艺、器件、电路、封装、测试和应用的全技术链创新，公司累计获得 387 项知识产权有效授权。其中 2025 年度新增授权专利 12 项，新增集成电路布图登记 49 项，前述新增授权的知识产权中 54% 以上为新型驱动、器件工艺和封装技术。

3、公司一次到三次服务器电源芯片进展情况？

2025 年，公司重磅推出 12 款面向 AI 计算能源领域的核心新品，全面完成服务器一次电源、二次电源到三次电源的全链路布局，其中面向 800V HVDC 系统的 1700V SiC 辅源、隔离驱动、SiC/GaN 驱动等芯片、兆赫兹开环 DCX 控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16 多相 VRM、70/90A Cu-Clip DrMOS、eFuse、PoL 等高性能功率产品可满足高算力服务器对电源转换效率、稳定性及小型化的要求。公司在一次电源的多款芯片已于 2025 年陆续进入多家服务器客户量产；二次电源多款芯片已经进

入种子客户试产；三次电源的多款产品已进入多家客户测试，其中个别型号即将试产。

4、2025 年度公司三个主要市场的营收情况？

工控功率类芯片：营收 2.1 亿元，同比增长 27.16%；家用电器类芯片：营收 7.58 亿元，同比增长 22%；标准电源芯片：营收 1.7 亿元，同比小幅下滑 2.03%。

5、2026 年一季度利润总额及净利润变动原因有哪些？

公司 2026 年第一季度实现营业收入 2.94 亿元，同比下降 2.57%；归母净利润 1372 万元，同比下降 66.59%；扣非净利润 1903 万元，同比下降 45.01%。主要系：（1）报告期内出于谨慎性计提存货跌价准备，从而影响资产减值损失同比增加；（2）受二级市场股票价格影响，本报告期内公司持有芯联集成（688469.SH）股票产生公允价值变动损失。

6、公司未来发展战略情况？

市场方面，公司长期坚持和高度看好“半导体能源赛道”，以全面覆盖 AI 计算、电力能源、智能终端、智能家电和工业控制等五大重点市场应用领域为战略市场目标。公司工业领域自 2015 年开始布局，以智能电网终端为起点，经过多年研发投入，工控功率芯片进一步拓展到更多的工业应用领域，包括数据中心、通信基站、光伏逆变器、储能、工业电机、新能源车等大功率工业场景。公司接下来将加大在机器人和 AI 计算等新兴领域迭代升级，加速提升为客户提供一站式“Power System Total Solution”。

产品线方面，公司持续深耕“电源和电机功率系统芯片及解决方案”战略，目前已基于五大核心技术（高低压集成工艺、智能功率器件、数模混合功率设计、多学科失效分析、高密度功率封装）构筑出六大具备协同效应的产

	<p>产品线(AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module) 架构。目前公司已开发超 2,000 个型号的产品, 在高低压集成半导体技术领域处于行业领先地位, 公司将通过持续创新的高效能、高集成及高可靠的智能化产品与技术, 未来三年, 基于全面升级的 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN 的全新智能功率芯片技术平台、多相数字技术平台和 DrMOS 特殊工艺技术平台, 满足终端整机系统不断升级的能源挑战, 以先进芯片驾驭电能, 把智慧能源普惠到每个人。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2026.6